

Product Overview

TMDS62LEVM 设计包内容概述



TMDS62LEVM_Download_Files List 文档列出了 TMDS62LEVM 中包含的所有文件夹名称和文件夹中的文件名，以及所有文件的格式（包括基于 ORCAD + ALLEGRO 的设计和基于 ALTIUM 的设计）。

TMDS62LEVM 评估模块 (EVM) 专为低成本和性能优化型 AM62L 系列应用处理器而设计。TMDS62LEVM 评估模块围绕 AM62L 处理器（11.9mm × 11.9mm，0.5mm VCA，373 引脚 FCCSP BGA 封装 (ANB)）构建，具有可扩展的 Arm® Cortex®-A53 内核性能和嵌入式功能，例如：多媒体 DSI 支持、片上集成 ADC、高级低功耗管理模式，以及用于 IP 保护和安全的广泛安全选项。产品概述文档可在 TI.com 上的 TMDS62LEVM 产品文件夹中获取，供客户在下载单个 Zip 文件夹之前查看。

表 1. Proc181E1-1 Orcad + Allegro

文件夹 (第 1 级)	文件夹 (第 2 级)	所含文件	文件类型
----	----	PROC181E1-1_Folders_Files_List	XLS
1_SCHEMATIC	1_ORCAD	PROC181E1-1_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	PDF
	2_PDF_标准	PROC181E1-1_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	PDF
	3_PDF_Intelligent	PROC181E1-1_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	DSN
2_BOM	----	PROC181E1-1_BOM	XLS
3_Board_File	Allegro	PROC181E1-1_BRD	BRD
	Simulation Scorecard	TMDS62LEVM_Simulations_Scorecard	PDF
	Altium_ASCII	PROC181E1-1_BRD	ALG
4_Gerber	ODBGBR	PROC181E1-1_ODBGBR	ZIP
	274X	PROC181E1-1_274XGBR	ZIP
	IPC-D-356_NETLIST	PROC181E1-1_IPC	IPC
5_Gerber_PDF	FAB	PROC181E1-1_FAB	PDF
	PCB LAYERS	PROC181E1-1_ALL_LAYER	PDF
	Gerber Layers	PROC181E1-1_ALL_LAYER	PDF
6_Assembly_Models_Package	2D	PROC181E1-1_DXF_BASY	DXF
		PROC181E1-1_DXF_TASY	DXF
	3D	PROC181E1-1_3D.STEP	STP
		PROC181E1-1_BRD	EMP
	IDF	PROC181E1-1_BRD	EMN
		PROC181E1-1 ASSEMBLY	PDF
	封装_Drawing	PROC181E1-1_TASY	PDF
		PROC181E1-1_BASY	PDF
		art_aper + 8 x .ART 文件	ART
	XY-REP	PROC181E1-1_XY_REP	XLS
7_PCB_LAYER_STACKUP	---	TMDS62LEVM-6L-20-12-2023-[1639]	PDF

表 1. Proc181E1-1 Orcad + Allegro (续)

文件夹 (第 1 级)	文件夹 (第 2 级)	所含文件	文件类型
8_Power_Supply_Sequencing	---	PROC181E1-1_POWER_SEQUENCE	PDF
9_SysConfig_PinMux_File	---	TMDS62LEVM	syscfg

表 2. Proc181E1-1 ALTIUM

文件夹 (第 1 级)	文件夹 (第 2 级)	所含文件	文件类型
----	----	PROC181E1-1_Folders_Files_List	XLS
1_SCHEMATIC	1_Altium	PROC181E1-1_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	.SCHDOC
	2_PDF_标准	PROC181E1-1_S_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	PDF
	3_PDF_Intelligent	PROC181E1-1_I_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	PDF
2_BOM	----	PROC181E1-1_BOM	XLS
3_Board_File	Altium	PROC181E1-1_PRJPCB	.PCBDOC .PRJPCB
	Board_pdf_dimensions	PROC181E1-1_BRD	PDF
	Simulation Scorecard	TMDS62LEVM_Simulations_Scorecard	PDF
4_Gerber	ODBGBR	PROC181E1-1_ODBGBR	TGZ
	274X	PROC181E1-1_274XGBR	ZIP
	IPC-D-356_NETLIST	PROC181E1-1_IPCD356	IPC
5_Gerber_PDF	FAB	PROC181E1-1_FAB	PDF
	PCB LAYERS	PROC181E1-1_ALL_LAYER	PDF
	Gerber Layers	PROC181E1-1_ALL_LAYER	PDF
6_Assembly_Models_Package	2D	PROC181E1-1_DXF_BASY	DXF
		PROC181E1-1_DXF_TASY	DXF
	3D	PROC181E1-1_3D.STEP	STP
	IDF	PROC181E1-1_BRD	EMP
		PROC181E1-1_BRD	EMN
	Assembly_Drawing	PROC181E1-1 ASSEMBLY	PDF
		PROC181E1-1_TASY	PDF
		PROC181E1-1_BASY	PDF
	STNL	PROC181E1-1_BRD_11_3 art_aper + 8 x .ART 文件	ART
XY-REP	_PROC181E1-1_XY_REPORT	XLS	
7_PCB_LAYER_STACKUP	---	TMDS62LEVM-6L-20-12-2023-[1639]	PDF
8_Power_Supply_Sequencing	---	PROC181E1-_POWER_SEQUENCE_IO_DDR.pdf	PDF
	---	PROC181E1-1_POWER_SEQUENCE_RTC_Only.pdf	PDF
9_3DBOARD_PDF	---	PROC181E1-1_3DBOARD	PDF

表 2. Proc181E1-1 ALTIUM (续)

文件夹 (第 1 级)	文件夹 (第 2 级)	所含文件	文件类型
10_Gerber_comparision_ALG _PRJPCB_pdf		PROC181E1-1_gerbet_comparision	PDF
11_Sysyconfig		TMDS62LEVM	.syscfg

参考资料

- [\[常见问题解答\] AM62L \(AM62L32、AM62L31\) 定制电路板硬件设计 - 针对重复使用 EVM TMDS62LEVM 原理图的设计和审阅注解](#)
- [\[常见问题解答\] AM62L \(AM62L32、AM62L31\) 定制电路板硬件设计-提供的设计文件和支持的 CAD 工具格式，可在定制电路板原理图和 PCB 设计中使用](#)

商标

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited.

所有商标均为其各自所有者的财产。

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月